

FUJIMI TODAY

vol.48

2018.4.1 ~ 2019.3.31

2019年6月発行

特集

フジミの製品が使用されるシーン

技術を磨き、心をつなぐ

FUJIMI

証券コード 5384



お客様目線の実践

パウダー&サーフェスカンパニーへの進化

「働きがい」と「働きやすさ」の醸成

当事者意識とやり抜く力の確立

革新への挑戦

技術を磨き、心をつなぐ

私たちの「磨く技術」は半導体をはじめとした
さまざまな産業で活かされています。

フジミはお客様にあらゆる製品を

磨いていただくことで、

人々が快適に暮らせる未来の創造に

貢献します。

代表取締役社長

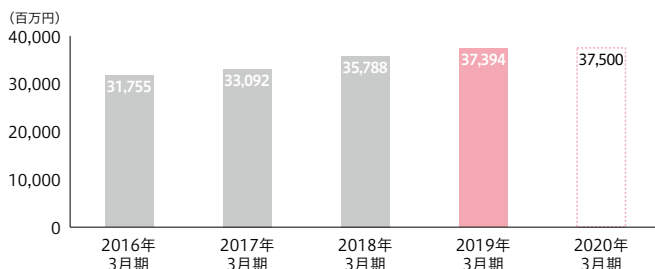
関 敬史



連結決算ハイライト

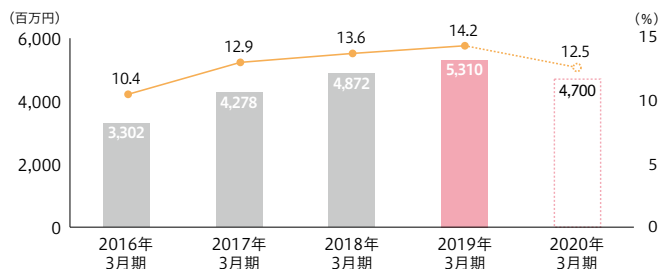
※2020年3月期は予想値

■売上高



■営業利益・営業利益率

折れ線グラフ：営業利益率 (右軸)



株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2019年3月期の経営成績

当社グループを取り巻く環境は、世界各国において政治・政策面での先行き不透明感はあるものの、米国では堅調に、日本・欧州では緩やかに景気回復が持続しました。一方で、中国では貿易摩擦の影響を受け景気は減速傾向にありました。また、世界半導体市場は、上期はロジックデバイス、メモリデバイスともに総じて需要は堅調でしたが、下期に入り、メモリデバイスの価格下落とともに半導体の需要減退の動きも見られ、稼働調整局面に入りました。

こうした状況下、当社グループでは一丸となって売上拡大とコスト削減に努めました結果、2019年3月期の業績は、売上高37,394百万円（前期比4.5%増）、営業利益5,310百万円（前期比9.0%増）、経常利益5,637百万円（前期比19.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は、2018年3月期に計上した特別損失がないこと、日本及び米国における税制の変更により実効税率が軽減したこともあり4,265百万円（前期比41.7%増）となりました。

2019年度経営方針

年度経営方針は、新たに1つ追加し、5つの方針を掲げました。

(1) お客様目線の実践：お客様の立場で考え行動することの重要性を垂訓するものです。

(2) パウダー&サーフェスカンパニーへの進化：研磨材中心の事業領域をパウダー（粉）とサーフェス（表面）に広げ、業態の「進化」をめざしています。

(3) 「働きがい」と「働きやすさ」の醸成：社員一人ひとりが働きがいを持って、安心して仕事に取り組める環境づくりを推進しています。

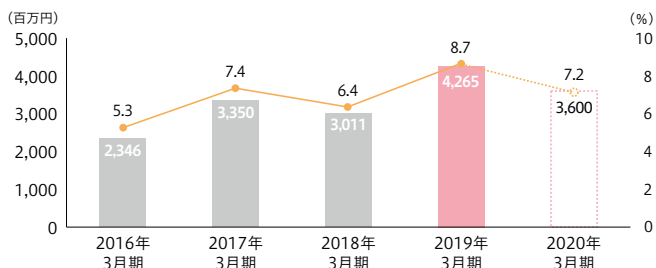
(4) 当事者意識とやり抜く力の確立：商機をつかみ着実に結果に繋げるには、中長期的な観点で地に足を付けて取り組まなければならない課題が多く存在します。そのためには、社員一人ひとりが当事者意識を持ち、業務に参画することが重要で、諦めずにチャレンジする、やり抜く、という強い思いを持って目標や課題に取り組むことを推進したく新たに経営方針に加えました。

(5) 革新への挑戦：当社は精密研磨材のトップメーカーとして長年業界をリードしてきましたが、現状に満足することなく、常に革新と成長を続ける企業でありたいと考えております。

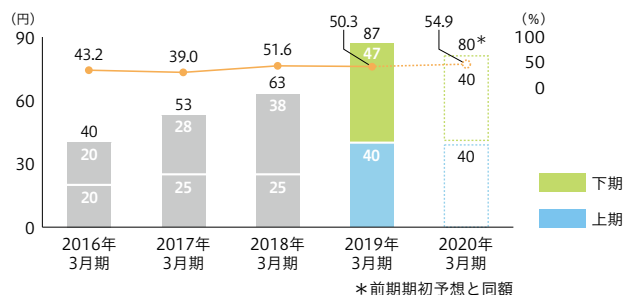
中長期経営計画の達成に向け、これら5つの方針のもと、全社一丸となって取り組んでまいります。

皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

■親会社株主に帰属する当期純利益・ROE 折れ線グラフ：ROE(右軸)



■配当金・連結配当性向 折れ線グラフ：連結配当性向(右軸)



特集

フジミの製品が 使用されるシーン

今回は、普段目に触れることのない当社の製品が、どのような最終製品づくりに利用され、皆様の生活に役立っているのかについて、イラスト等を利用してご紹介いたします。



当社はパソコン・スマートフォンなどに搭載されている電子部品やデジタルカメラ・メガネのレンズ、自動車のボディなどの表面加工に使われる精密研磨材を製造・販売しています。1950年の創業以来、粉碎・分級技術などを活かした精密人造研磨材メーカーのパイオニアとして独自の歩みを続けています。

蓄積されたノウハウと研究開発力から生まれた製品の数々は、光学レンズ用研磨材から出発し、シリコンウェハーに代表される半導体基板の鏡面研磨、半導体チップの多層配線に必要なCMP*（化学的機械的研磨）、パソコンやサーバーなどの記録媒体であるハードディスク基板の研磨

など高精度が求められる先端分野に欠かせぬものとなっています。

ナノ（10億分の1）メートルの精度が求められる半導体集積回路の配線では、基板となるシリコンウェハーの表面にわずかな凹凸や傷があっても断線につながります。例えば、直径300mmのウェハーで要求される平坦度を東京～名古屋間の約300kmで置き換えていうとわずか1cmの段差も許されないレベルの平坦度となります。

現在、当社の精密研磨材は、半導体シリコンウェハー製造工程で使用されるラッピング材*、ファイナルポリシング材*でいずれも世界シェアの約9割を占めています。



電子部品 (CPU)



ラッピング材



ポリシング材

シリコンウェハー向け研磨材 市場シェア

ラッピング材 ファイナルポリシング材



2019年3月 自社推計

CMP

Chemical Mechanical Planarization 又は Chemical Mechanical Polishing の略。薬液の化学的作用と砥粒の機械的研磨作用により半導体デバイスの多層配線を平坦化する技術。

ラッピング材

シリコン基板等を粗磨きするための粉末研磨材。

ポリシング材

ラッピング材よりもさらに細かな砥粒と薬液を配合した鏡面仕上げ用の研磨スラリー(液体研磨材)。

フジミのコア技術と製品展開

▶ フジミのコア技術

当社には「ろ過・分級・精製技術」、「パウダー技術」、「ケミカル技術」の3つのコア技術があります。「ろ過・分級・精製技術」とは、粒子を均一にしたり、粗大粒子を除去する技術を指します。「パウダー技術」とは、用途に合わせた粒子の選定、形状制御及び評価を行う技術を指し、ミクロン（100万分の1メートル）単位での粒子制御が可能です。「ケミカル技術」とは、分散・溶解・表面保護等の機能を持つ薬液を設計・配合・選定する技術を指します。当社はこれらコア技術を組合せ、様々な用途向けの研磨材や機能性材料、溶射材を開発、製造、販売しています。



▶ 研磨対象用途の具体例

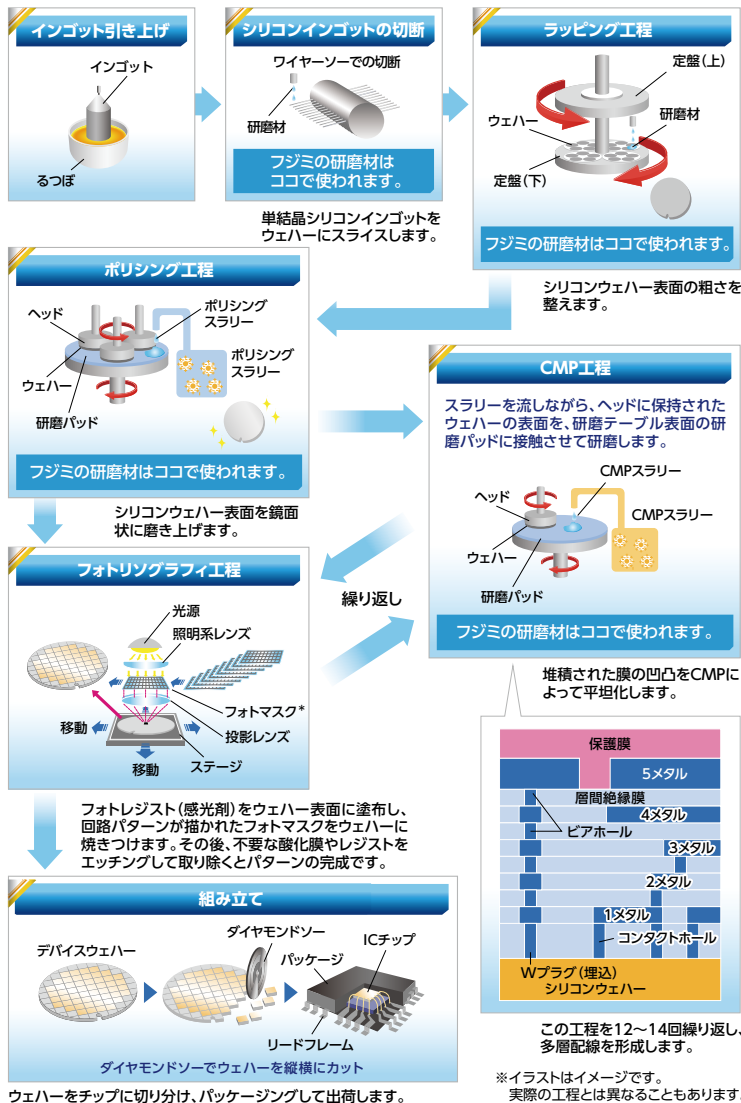
〈シリコンウェハー〉半導体デバイスウェハーには微細な配線が施されます。データ容量、処理能力等はその配線間隔に依存するため、年々微細化が進み、現在ではその配線間隔が5ナノメートル台が登場しております。この要求に応えるにはシリコンウェハーに対し①平坦性、②平滑性、③無欠陥、④無汚染が求められ、研磨スラリーを用いた精密加工が施されます。

▶ 精密研磨技術:フジミの研磨スラリー

研磨スラリーは、シリコンウェハーの精密研磨に用いられるのみならず、半導体デバイスの多層配線の平坦化（CMP）にも使用されます。この研磨スラリーは、砥粒と各種添加剤、水から構成されています。各種添加剤には、研磨を促進するものや過度な研磨を抑制するもののほか、研磨表面へのダメージを軽減するもの、更には研磨スラリーの物理的、化学的安定性に寄与するものがあります。近年のお客様の高度な要求に応えるには研磨スラリーの各成分の独自設計及び配合や改良が重要で、ここに当社のオリジナリティの高い設計技術とその製品化を可能とする生産技術が力を発揮します。

シリコンウェハーや半導体デバイスの製造に寄与する当社製品の技術力や品質は、世界最大の半導体メーカーであるインテル社から2014年度より5年連続でアワードを受賞したことで証明されています。

フジミの製品が使用される半導体工程



半導体素子の基板として使用されるシリコンウェハーは、シリコンの塊(シリコンインゴット)からワイヤーソー*で薄くスライスする切断工程で使用される当社製品が GC シリーズです。

その後のスライスされたシリコンウェハー表面の粗さを整えるラッピング工程に使用される当社製品が FO シリーズや PWA シリーズです。



GC



FO

さらにシリコンウェハーを鏡面状に研磨するポリシング工程で使用される当社製品が GLANZOX シリーズです。

また、半導体素子はウェハー上に回路を多層化し、製造されます。回路を積層するためには絶縁膜や配線を平坦化するCMP工程が必要で、そのときに使用される当社製品が PLANERLITE シリーズです。



GLANZOX



PLANERLITE

ワイヤーソー

細いワイヤーに研磨材と加工液を混ぜたスラリーをかけながら切断加工する機械。

フォトマスク

電子部品の回路パターン等を被転写対象に転写する際の原版。

暮らしの中に使用されているフジミの製品一例



自動車



■ カーナビ

カーナビに使用されている半導体にポリシング材(当社製品: GLANZOX、PLANERLITE)などが使われています。



■ ブレーキパッド

ブレーキパッドのフィラー材(充填材、当社製品: WA、C)に使われています。



■ ボディ部分

塗装前、塗装後のボディ研磨の研磨布紙原料としてラッピング材(当社製品: FO、A、PWA、GC、C)などが使われています。



■ 駆動系部分

エンジンシリンダー、ドライブシャフト、ギア、ベアリングを研磨する砥石用原料としてラッピング材(当社製品: FO、A、PWA、GC)などが使われています。



電子部品 (スマートフォンの場合)



■ 半導体デバイス(CPU、メモリなど)

ラッピング材(当社製品: FO)
ポリシング材(当社製品: GLANZOX、PLANERLITE)

■ 水晶振動子・SAWフィルタ部分

ラッピング材(当社製品: FO、A、PWA、GC)
ポリシング材(当社製品: COMPOL)



FO



A、WA



GC、C



COMPOL



GLANZOX

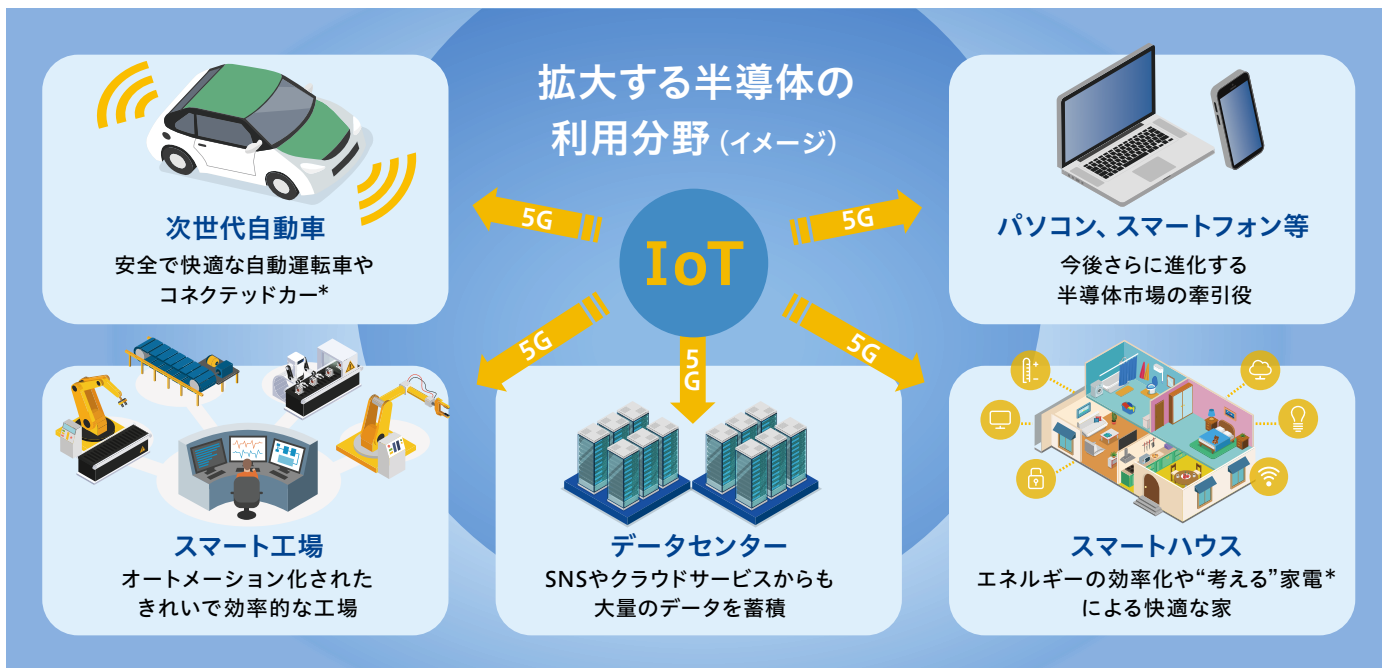
ますます需要が高まるフジミの技術・製品（IoT、5G）

フジミの製品が使用されている半導体市場は中長期的に成長を続けており、将来的にも拡大が見込まれています。半導体は、AI（人工知能）や自動運転など世界中が注目する最新技術や、来たるべきIoT*社会に欠かせないものです。あらゆるモノがインターネットでつながるIoT社会は、近年の第5世代移動通信（以下、5G）が急速に具現化したことで大きく前進しました。

これらの技術革新は私たちの暮らしをより快適に変えていきます。たとえば5Gは、2時間の映画を3秒でダウンロードを可能にしたり、精密に動く産業用ロボットの操作をリア

ルタイム通信で行えるようにします。そして、5Gなどのさまざまな技術に支えられて実現するIoT社会では、自動化や効率化が図られ、家・オフィス・工場、ひいては街全体がスマートに進化します。IoTサービスはすでに普及しつつあり、病院の患者ケア、農作物や水産物の生育監視、ビルの設備管理や自然災害の予兆察知など、幅広い分野で活用されています。

こうした新しい社会、より快適な暮らしに貢献するのが半導体分野でありフジミの製品です。半導体デバイスの用途拡大に伴い、フジミの技術・製品は今後ますます需要が高まっていきます。



IoT

Internet of Things の略。世の中に存在するさまざまなモノに通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信したりすること。

コネクテッドカー

通信機能を装備した車。

“考える”家電

AIやセンサーなどが人に成り代わって最適な動き方を考え、便利で快適な衣食住を提案する家電。

京大発のベンチャー企業FLOSFIAに出資

当社は、新たな成長に向け自社開発だけでなく先進技術を保有するベンチャー企業への投資も行っています。今回は、2019年5月に出資を行った株式会社FLOSFIA（以下、FLOSFIA社）をご紹介します。なお、FLOSFIA社への出資は、当社が設立したコーポレート・ベンチャー・キャピタルファンドからも同時に実施しており、同ファンドからの出資は2017年3月に続き2度目となります。

FLOSFIA社は2011年に創業した京大発のベンチャー企業で、同社独自技術であるミストドライ®法（図1）を用い、パワーデバイス事業と成膜ソリューション事業に取り組んでおり、コランダム構造酸化ガリウム*を材料とした次世代パワー半導体をウェハー加工からデバイス組立てまで一貫して製造できる世界で唯一のメーカーです。

出資の目的・今後の展開

次世代パワー半導体は今後急激な需要拡大が予測されており、酸化ガリウム*は従来のシリコンや炭化ケイ素に比べ、電力変換効率に優れ、省エネルギー・コスト低減・小型軽量化を実現し得ると期待されています。当社は、FLOSFIA社の酸化ガリウムを用いた次世代パワー半導体の事業化加速に向け出資するとともに研磨に関わる製造プロセス構築に向け協業することで、事業の発展ならびに低炭素社会の実現に貢献したいと考えています。

株式会社FLOSFIA 人羅代表取締役社長より

FLOSFIA社では、京大発の新しいパワー半導体新材料「コランダム構造酸化ガリウム」を用いて、さまざまな電力変換器の技術革新にチャレンジしています。現在、最初の商品であるダイオードの量産準備中で、特許出願数は300件を超えています。初期はACアダプタなど家電向け電源、その後、PVパワーコンディショナーやインバーター、モーター駆動などの高耐圧製品や低耐圧製品への応用展開を目指しています。今後、ダイオードのラインナップを増やすとともに、トランジスタの製品化・量産化を加速させ、より幅広い産業領域への展開を目指しています。

代表取締役社長 人羅 俊実

半導体領域のシリアルアントレプレナー。

2012年FLOSFIA（当時社名：ROCA（株））代表取締役に就任し、急成長が期待される産業領域である「電動化」・「自動化」・「IoT」において、「小型」・「低損失」のキーとなるパワー半導体の開発に注力。

誰も注目していなかった新材料を用いて、パワーデバイスで世界トップデータを実現するなど事業を牽引。1998年京都大学工学部工業化学科卒業、2000年奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科修了。



■ 投資先企業概要

法人名：株式会社FLOSFIA（フロスフィア）
<http://flosfia.com/>

所在地：本社 京都府京都市西京区御陵大原1番29号

設立：2011年3月31日

資本金：2,908百万円（資本準備金等含む）
（2019年5月27日現在）

事業内容：酸化ガリウム系パワーデバイスの研究・製造・販売と各種金属酸化膜等の受託成膜、コーティング

■ ミストドライ®法

※「ミストドライ®」はFLOSFIA社の登録商標です。

ミスト（霧）を活用して、薄い膜を原子層のレベルで積層していく技術で酸化膜や金属膜、有機膜などさまざまな物質の薄膜が成膜できます。

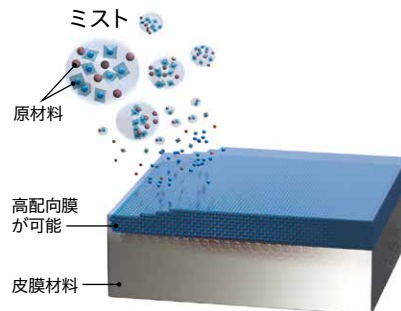


図1

▶ 酸化ガリウム

無機化合物の1つ。近年、炭化ケイ素や窒化ガリウムと同様に、パワー半導体の材料として注目されています。

用途別の動き

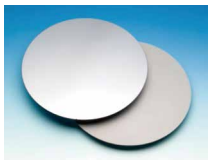
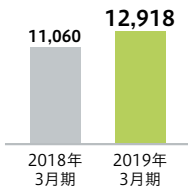
シリコンウェハー用

売上構成比 34.5%

当第3四半期まで半導体業界の稼働が高い水準であったことに加え、当社製品の採用が拡大したことから、ラッピング材の売上高は4,297百万円(前期比19.8%増)、ポリシング材の売上高は8,621百万円(前期比15.4%増)となりました。

半導体基板となるシリコンウェハーを高精度に平坦化・鏡面化する研磨工程で用いられる研磨材を製造販売する事業です。

■ 売上高 (単位: 百万円)



シリコンウェハー

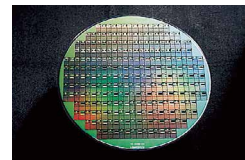
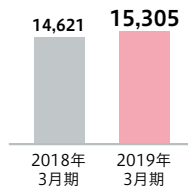
CMP用

売上構成比 40.9%

半導体業界の高稼働を背景に、ロジック、メモリともに最先端デバイス向け製品需要が堅調に推移したことにより、売上高は15,305百万円(前期比4.7%増)となりました。

半導体デバイスの製造工程で用いられる研磨材を製造販売する事業です。

■ 売上高 (単位: 百万円)



デバイスウェハー

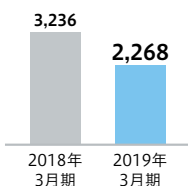
ハードディスク

売上構成比 6.1%

SSD (ソリッドステート・ドライブ) への置き換えによる市場の縮小及び顧客の生産プロセスの変更の影響により、売上高は2,268百万円(前期比29.9%減)となりました。

パソコンやデータ保管をするサーバーの記憶装置に搭載されているハードディスク用基板の研磨材を提供しております。

■ 売上高 (単位: 百万円)



サーバー

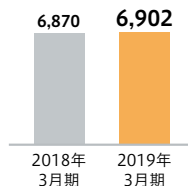
一般工業用・溶射材等

売上構成比 18.5%

非半導体関連の一般工業用研磨材につきましては、売上高は3,931百万円(前期比7.4%減)、その他につきましては、2,971百万円(前期比13.2%増)となりました。

多種多様な用途向けに研磨材や機能性材料を提供しております。また、鉄鋼、航空機及び半導体などさまざまな業界の溶射用途向けに溶射材を提供しております。

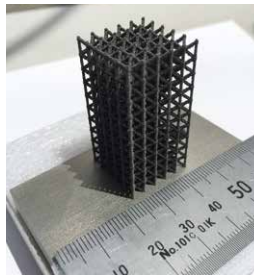
■ 売上高 (単位: 百万円)



溶射材の主力製品 SURPREX

「革新的金型製造技術の開発とその産業応用」を発表

当社は2019年3月18日「知の拠点あいち重点研究プロジェクト（II期）（<http://www.astf-kha.jp/project/>）の最終成果発表会にて「革新的金型製造技術の開発とその産業応用」の発表を行いました。



会社案内映像をリニューアル

2019年4月1日に、会社案内映像をリニューアルしました。当社の企業文化ビジョン「強く、やさしく、面白い」をベースに制作しています。

<http://www.fujimiinc.co.jp/company/video.html>



プリファード・クオリティー・サプライヤー(PQS)賞

米国インテル社がその絶えまない卓越性への追求と確固としたプロフェッショナリズムを備えた事業活動を行う企業を表彰するもの。

PQS賞の受賞

当社の米国子会社であるFUJIMI CORPORATIONが、米国インテル社より2018年度プリファード・クオリティー・サプライヤー（PQS）賞*を受賞しました。受賞企業の中で、CMPスラリーのメーカーは、当社のみであり、5年連続の受賞となります。



中国語ホームページの開設

2019年4月23日より中国語（簡体字）に対応したホームページを開設しました。

<http://www.fujimiinc.co.jp/chinese/>



連結財務諸表

連結損益計算書

	2018年3月期	2019年3月期
売上高	35,788	37,394
売上原価	21,081	21,785
売上総利益	14,706	15,609
販売費及び一般管理費	9,834	10,299
営業利益	4,872	5,310
営業外収益		
受取利息	59	117
その他	76	240
営業外収益合計	135	357
営業外費用	279	31
経常利益	4,728	5,637
特別損失	568	—
税金等調整前当期純利益	4,160	5,637
法人税、住民税及び事業税	1,240	1,384
法人税等調整額	△91	△13
当期純利益	3,011	4,265
親会社株主に帰属する当期純利益	3,011	4,265

(単位：百万円)

売上高

世界半導体市場は、メモリデバイスの価格下落や半導体の需要減退の動きも見られ、2019年初頭より稼働調整局面に入りましたが、当第3四半期まで半導体業界の稼働が高い水準であったことに加え、当社製品の採用が拡大したことからシリコンウェハー及びCMP向け製品の販売は好調に推移しました。一方でSSD（ソリッドステート・ドライブ）への置き換えによる市場の縮小や顧客の生産プロセスの変更の影響でハードディスク向け販売は減少したものの、売上高は前期比4.5%増の37,394百万円となりました。

営業利益

売上拡大とコスト削減に努めました結果、前期比9.0%増の5,310百万円となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益

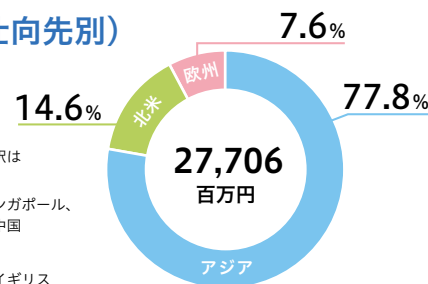
前期に特別損失を計上していたこと、日本及び米国における税制の変更により実効税率が軽減したこともあり4,265百万円（前期比41.7%増）となりました。

海外売上高（仕向先別）

(2019年3月期)

※各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりです。

- アジア：台湾、ベトナム、シンガポール、マレーシア、韓国、中国
- 北米：米国、カナダ
- 欧州：ドイツ、イタリア、イギリス



海外売上高

	2018年3月期	2019年3月期
海外売上高	26,769	27,706
連結売上高	35,788	37,394
連結売上高に占める割合	74.8%	74.1%

(単位：百万円)

連結貸借対照表

2018年3月期 2019年3月期

資産の部	2018年3月期	2019年3月期
流動資産		
現金及び預金	24,929	21,852
受取手形及び売掛金	8,010	8,001
有価証券	500	3,500
たな卸資産	5,793	7,253
その他	772	634
貸倒引当金	△23	△26
流動資産合計	39,983	41,216
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	7,822	7,494
その他(純額)	5,527	6,383
有形固定資産合計	13,349	13,877
無形固定資産	479	400
投資その他の資産		
投資有価証券	744	1,455
繰延税金資産	749	777
その他	141	130
貸倒引当金	△9	△9
投資その他の資産合計	1,626	2,354
固定資産合計	15,456	16,632
資産合計	55,439	57,848

(単位：百万円)

2018年3月期 2019年3月期

負債の部	2018年3月期	2019年3月期
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,269	2,517
未払法人税等	429	789
賞与引当金	1,115	1,073
株式給与引当金	—	294
その他	1,952	2,172
流動負債合計	6,767	6,848
固定負債		
退職給付に係る負債	651	701
株式給与引当金	153	15
その他	18	51
固定負債合計	823	768
負債合計	7,591	7,616
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,753	4,753
資本剰余金	5,570	5,570
利益剰余金	42,718	45,031
自己株式	△5,641	△5,641
株主資本合計	47,401	49,714
その他の包括利益累計額	446	517
純資産合計	47,848	50,231
負債純資産合計	55,439	57,848

(単位：百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べて726百万円増加し、4,397百万円の収入となりました。これは、たな卸資産の増加があったものの、税金等調整前当期純利益の増加による資金の増加があったことによります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果支出した資金は、600百万円減少し、3,281百万円の支出となりました。これは主に前期に定期預金の預入れによる支出が多かったこと等によります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は、646百万円増加し、1,954百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払いがあったことによります。

配当金及び連結配当性向の推移

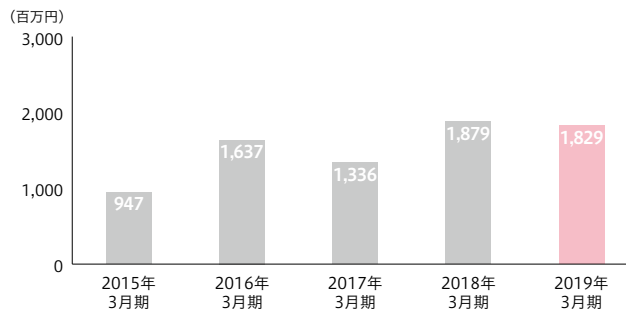
当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、配当につきましては連結配当性向を50%以上とし、業績に応じた積極的な株主還元を実施するとともに安定配当の継続にも留意することを基本方針としております。このような方針のもと、当期末配当金につきましては、直近の配当予想として1株につき45円を予定しておりましたが、2円増配の1株につき47円といたします。この結果、中間配当を含めた当期の配当金は、1株につき87円となります。

連結キャッシュ・フロー計算書

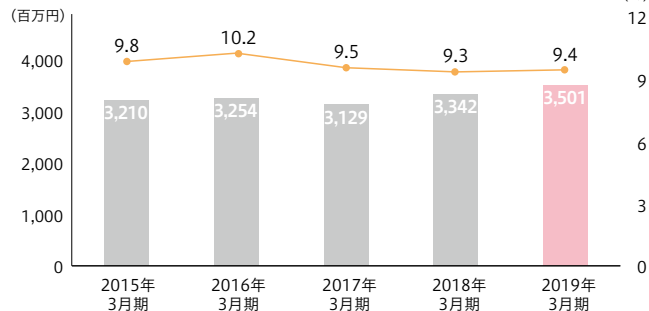
	2018年3月期	2019年3月期
● 営業活動によるキャッシュ・フロー	3,671	4,397
● 投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,882	△3,281
● 財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,308	△1,954
現金及び現金同等物に係る換算差額	23	62
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,496	△777
現金及び現金同等物の期首残高	24,832	23,336
現金及び現金同等物の期末残高	23,336	22,559

(単位：百万円)

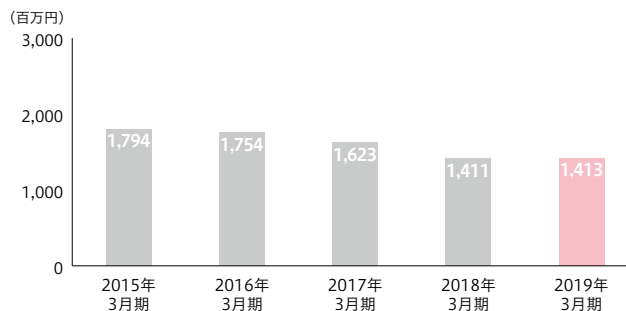
■ 設備投資



■ 研究開発費・売上高比



■ 減価償却費



株式情報 2019年 3月 31日現在

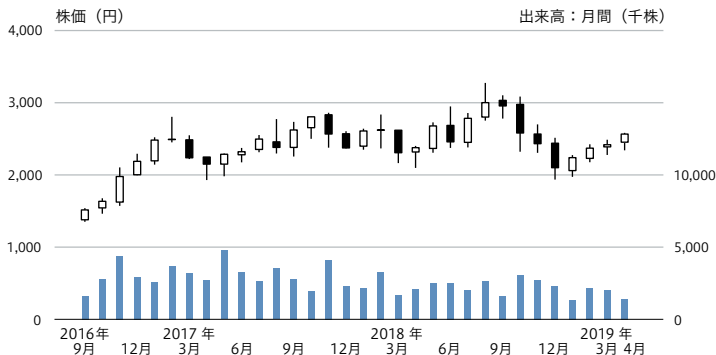
株式の状況

株式数 発行可能株式数	120,000千株
発行済株式総数	28,699千株
株主数	5,678名

大株主(株主名)	持株数(千株)	持株比率(%)
有限会社コマ	3,743	13.0
株式会社フジインコーポレーテッド	3,667	12.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,618	5.6
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,599	5.5
株式会社三菱UFJ銀行	728	2.5
越山 勇	717	2.4
日本生命保険相互会社	639	2.2
フジミ取引先持株会	639	2.2
一般財団法人越山科学技術振興財団	600	2.0
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)	571	1.9

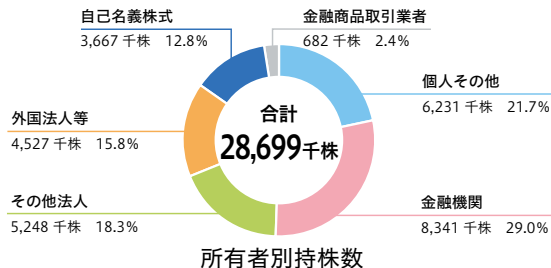
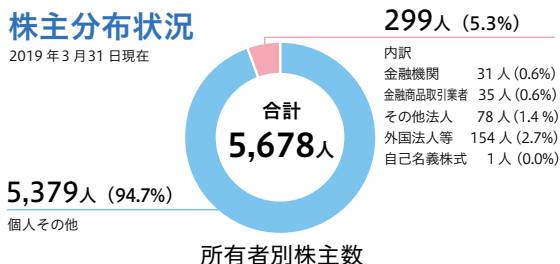
*持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2以下を切り捨てています。

株価及び出来高の推移



株主分布状況

2019年 3月 31日現在



役員

2019年
6月21日現在

代表取締役社長	関 敬史
常務取締役	伊藤 広一
取締役	鈴木 彰
取締役	大脇 寿樹
取締役	鈴木 勝弘
取締役	川下 政美*
取締役	浅井 侯序*
常勤監査役	藤川 佳明
監査役	高橋 正彦**
監査役	岡野 勝**

(*印は社外取締役) (**印は社外監査役)

会社データ 2019年 3月 31日現在

商号	株式会社フジインコーポレーテッド
証券コード	5384
本社所在地	愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1 TEL. 052-503-8181 (代表)
設立年月日	1953年(昭和28年)3月20日
資本金	4,753百万円
代表者	代表取締役社長 関 敬史
従業員	861名(個別588名)

株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日
配当金受領株主確定日	期末配当金：3月31日 中間配当金：9月30日
単元株式数	100株
定時株主総会	毎年6月
公告方法	電子公告 (http://www.fujimiinc.co.jp) ただし、事故その他やむを得ない事情によって 電子公告による公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に掲載することといたします。
株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先 及び照会先	〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711 (通話無料)

各種手続のお申出先

- 支払期間経過後の配当金のお支払いについては、株主名簿管理人にお申出ください。
- 住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等

証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券会社へお申出ください。
証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社へお申出ください。

【ご注意】

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、日本証券代行為口座管理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理人に、お問合わせください。

特別口座管理機関 連絡先	日本証券代行株式会社 〒168-8620 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 日本証券代行株式会社 代理人部 電話 0120-707-843 (通話無料)
-----------------	---

株式会社フジミインコーポレーテッド

お問い合わせ先：経営企画部経営企画課
TEL：052-503-8181 (代表)
URL：<http://www.fujimiinc.co.jp>

Copyright (C) 2019 Fujimi Incorporated. All rights reserved.



この印刷物は、環境負荷低減のため古紙/ループを80%使用した環境対応紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しております。